

证券代码：300567

证券简称：精测电子

公告编号：2023-069

武汉精测电子集团股份有限公司

关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“精测电子”）于2023年4月20日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下：

为满足公司及子公司生产经营目标及发展需要，现计划以流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、票据贴现、票据池、商业保理以及其他方式，公司及子公司拟向银行申请最高额不超过73.3亿元人民币及4.1亿元新台币的综合授信额度，最终以各家银行实际审批的授信额度及授信期限为准。综合授信额度有效期自2022年度股东大会审议批准之日起至2023年度股东大会召开之日止，在授权期限内可循环使用。公司董事会授权公司董事长彭骞先生，办理上述综合授信额度内的一切授信的相关手续，并签署有关法律文件。

上述银行综合授信事项尚需提交公司2022年度股东大会审议批准后方可实施。

备查文件

1、《武汉精测电子集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2023年4月21日